## 放射光を用いたシロキサン含有ブロック共重合化ポリイミドの 相分離構造と特異的な低熱膨張挙動の解析

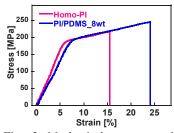
東工大物質理工¹·山形大院有機²·JSR(株)³ 〇百瀬 敦都<sup>1</sup>·松田 直樹<sup>2</sup>·東原 知哉<sup>2</sup>·丸山 洋一郎<sup>3</sup>·藤冨 晋太郎<sup>3</sup>·安藤 慎治<sup>1</sup>·石毛 亮平<sup>1</sup>

【緒言】 ポリイミド(PI)はその優れた耐熱性や電気 絶縁性から、電子回路基板の絶縁層などに利用され、 近年のフレキシブルデバイスの発展に伴い、より高 い靭性が要求されている.これに有効な手段として, 極めて柔軟な高分子であるポリジメチルシロキサン

Fig. 1 Chemical structure of PI/PDMS.

(PDMS)との共重合が検討されてきた. しかし高分子の中でもとりわけ熱膨張率が大きい PDMS との共 重合化は PI の熱寸法安定性の低下につながる.一方,当研究室のこれまでの検討から,含フッ素全芳香 族 PI, PMDA-TFDB と PDMS のマルチブロック共重合体 (PI/PDMS, Fig. 1) が, PMDA-TFDB 単独重合 体(Homo-PI)の結晶格子に比べてさらに小さい体積熱膨張率(CVE)を示すことを見出している.本研究 では、PDMS の共重合による PI の靭性向上を目指すとともに、放射光 X 線を用いて昇温過程における PI/PDMS の構造変化を解析し、PI/PDMS が示す低 CVE の発現機構の解明を試みた.

PDMS と PAA を共重合化した前駆 体溶液(PDMSの重量分率/WPDMS:4,8,12,16,20, 24, 28, 32wt%, PDMS の Mw は 4400g mol<sup>-1</sup> に 固定)をガラス基板上にブレードコート後, 70°C で乾燥させ, 400°C で熱処理し PI/PDMS 膜を作製した(乾燥, 熱処理は窒素雰囲気下で 実 施 ).  $W_{\rm PDMS}$  が 8wt% の PI/PDMS 膜 (PI/PDMS 8w)を短冊状に切り出し引張試験を 行った.また,無染色 PI/PDMS\_8w の断面を透 過型電子顕微鏡 (TEM) で観察した. 各 PI/PDMS Homo-PI and PI/PDMS 8wt film. 膜の面内および面外方向の線熱膨張係数 CTE//



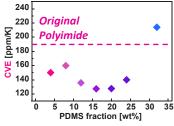


Fig. 2 Mechanical property of

Fig. 3 CVE of PI/PDMS depend on weight fraction of PDMS.

および CTE」を、TMA 法および近赤外干渉分光法によりそれぞれ計測し、それらの総和から CVE を評 価した. 温度可変小角 X 線散乱(VT-SAXS)測定を行い、昇降温中における PI/PDMS 膜の偏析構造の変 化を調査した. KI 水溶液を用いた浮沈法により各 PI/PDMS 膜の密度を測定し、さらに PI/PDMS 膜と Homo-PI 膜の密度, および W<sub>PDMS</sub> から, PI/PDMS 中における PDMS の密度を算出した.

PI/PDMS 8wt は Homo-PI と比較し、破断強度は約 15%、破断伸びは約 40%増加した とともに,同程度のヤング率を示した(**Fig. 2**). また, PI/PDMS 膜の CVE は  $W_{PDMS}$  < 20wt%までは  $W_{PDMS}$ の増加と共に低下、それ以上では上昇し、 $W_{PDMS}$ が 24wt%以下の膜において Homo-PI 膜の CVE に比べ 有意に小さい値を示した(Fig.3). PI/PDMS 8wt 膜断面の TEM 像(Fig.4)には, 明るい灰色の背景(PI 相)

の中に暗い島状の領域(PDMS 相)が観測され、PDMS 相が面内(In-plane)方向 に沿って一定間隔で配列している相分離構造の形成を確認した. PI/PDMS 8wt に対する VT-SAXS 測定によって得られた SAXS 強度曲線, および不変量 Q の 温度変化を Fig. 5 に示す. 室温において相分離の周期構造に起因する散乱ピ ークが見られ、その長周期長(約30 nm)は TEM 観察で評価した寸法と一致し た. また、Qは配向に依存しない積分強度に対応し、相分離構造を形成する両 相の形状,体積分率,および電子密度差 Δρ の関数である(ラメラ状周期の場 合  $Q = \Delta \rho 2 \varphi (1-\varphi)$ ,  $\varphi$  は体積分率). 昇温により SAXS 強度曲線はその形状を維 持しつつ、強度および Q が顕著に減少し、PI/PDMS は昇温過程で相分離形態 を維持しつつ PI、PDMS 両相間の電子密度差が減少することが示唆された.

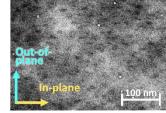
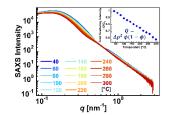


Fig. 4 2D TEM image of cross PI/PDMS 8wt section observed without staining.

密度測定によって算出した PI/PDMS 中の PDMS 密度は、いずれの試料においても PDMS 単体の密 度(0.97)を下回り、 $W_{PDMS}$  との相関が  $W_{PDMS}$  vs. CVE の傾向とよく一致することが判明した(Fig. 6). 以上のことから、PI/PDMS の低 CVE の発現 は、昇温により PI、PDMS 両相が相分離界面にお いて部分相溶化したこと, もしくは室温において 過剰に低密度化した PDMS が昇温により高密度化 したことに起因すると考えた. 当日は, PDMS 分 子量を調製した PI/PDMS についても報告する.



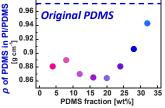


Fig. 5 Temperature dependence of Fig. 6  $\rho$  of PDMS in PI/PDMS SAXS profile and Q of PI/PDMS. depend on fraction of PDMS.

Analysis of Phase-Separated Structure and Unique Low Thermal Expansion Behavior of Siloxane-Containing Block Copolymerized Polyimides Using Synchrotron Radiation <u>Atsuto MOMOZE<sup>1</sup></u>, Tomoya HIGASHIHARA<sup>2</sup>, Naoki MATSUDA<sup>2</sup>, Yoichiro Maruyama<sup>3</sup>, Shintaro Fujitomi<sup>3</sup>, Shinji ANDO<sup>1</sup>, Ryohei ISHIGE<sup>1</sup>, (¹Dept. Chem. Sci. Eng. Tokyo Institute of Technology, 2-12-1-E4-5, Ookayama, Meguro-ku, Tokyo, 152-8552 Japan, <sup>2</sup>Grad. Sch. Org. Mater. Sci., Yamagata University, 4-3-16 Jonan, Yonezawa, Yamagata 992-8510 Japan, <sup>3</sup>JSR Corp. 100 Kawajiri-cho, Yokkaichi-shi, Mie 5108552, Japan) TEL & FAX: +81-3-5734-2889, E-mail: momoze.a.aa@m.titech.ac.jp